



# Prüfungen MINI-SNAP Silikonvergüsse Tests MINI-SNAP silicone pottings

**Geprüfte Teile / Tested items:**

MINI-SNAP Geräteteile Baugröße 0 und 3  
/ MINI-SNAP receptacles size 0 and size 3

Die Geräteteile wurden im Anschlussbereich mit Momentive TSE3991 C oder Dow Corning SE 9187 vergossen.

*/ The receptacles were potted at termination area with Momentive TSE3991 C or Dow Corning SE 9187*

Beide Vergussvarianten wurden in 2 Gruppen eingeteilt:

*/ Both potting variants were divided into 2 groups:*

1. Initiale thermische Belastung durch Reflow-löten  
*/ Initial thermal stress from reflow soldering*
2. Initiale thermische Belastung durch Wellenlöten  
*/ Initial thermal stress from wave soldering*

Die Prüflinge beider Gruppen wurden folgenden Belastung und Tests unterzogen:

*/ The test items of both groups were subjected to the following stresses and tests:*

Prüfung / Test	Prüfvorschrift / Test specification	Sollwert / Target value	Ergebnis / Result	
			Momentive TSE3991 C	Dow Corning SE 9187
Dichtigkeitsprüfung im Neuzustand <i>/ Tightness test in new condition</i>	DIN EN 60068-2-18 0,3 bar / 30 min	Kein Wasseraustritt <i>/ No water leak</i>	I. O. <i>/ Passed</i>	I. O. <i>/ Passed</i>
Thermischer Schock <i>/ Thermal shock</i>	-65 °C – 150 °C	-	-	-
Dichtigkeitsprüfung <i>/ Tightness test</i>	DIN EN 60068-2-18 0,3 bar / 30 min	Kein Wasseraustritt <i>/ No water leak</i>	I. O. <i>/ Passed</i>	I. O. <i>/ Passed</i>
Feuchte Wärme <i>/ Moist heat</i>	240 h, 85 % - 95 %, 28 °C – 71 °C	-	-	-
Dichtigkeitsprüfung <i>/ Tightness test</i>	DIN EN 60068-2-18 0,3 bar / 30 min	Kein Wasseraustritt <i>/ No water leak</i>	I. O. <i>/ Passed</i>	I. O. <i>/ Passed</i>
Autoklavierzyklen <i>/ Autoclave cycles</i>	500 Zyklen, 134 °C Kurzprogramm <i>/ 500 cycles, 134 °C short program</i>	-	-	-
Dichtigkeitsprüfung <i>/ Tightness test</i>	DIN EN 60068-2-18 0,3 bar / 30 min	Kein Wasseraustritt <i>/ No water leak</i>	I. O. <i>/ Passed</i>	I. O. <i>/ Passed</i>

Quelle: Bericht Nr. 00097